

第 22 回 電子デバイス実装研究委員会プログラム

日時:平成 30 年 7 月 2 日(月) 10:30~16:30

場所:日本橋ライフサイエンスビルディング 9 階 911-913 会議室 (東京都中央区)

時 間	題 目	講 演 者
10:30~ 11:50	司会 西川 宏(大阪大学)	
	『マイクロリアクターを利用した銅の電析における有機系添加剤の吸脱着挙動の解析』 (40 分)	○齊藤 丈靖 (大阪府立大学)
	『3次元積層実装技術に関する研究開発プロジェクトの取り組み状況』 (40 分)	○青柳 昌宏 (産業技術総合研究所)
11:50~ 12:50	昼 食 休 憩	
12:50~ 13:00	委 員 会 議 事	
13:00~ 15:00	司会 森 三樹 (東京大学)	
	『カーエレクトロニクス・実装技術の動向と電気接点の研究』 (40 分)	○三宅 敏広 ((株)デンソー)
	『自動車用電気電子部品の実装材料技術』 (40 分)	○石井 利昭、露野 円丈、伊藤 真紀、紺野 哲豊((株)日立製作所)、棚瀬 智和(日立オートモティブシステムズ(株))
	『実装技術と小型情報端末の発展』 (40 分)	○小勝 俊亘 (NECソリューションイノベータ(株))
15:00~ 15:10	休 憩	
15:10~ 16:30	司会 柴崎 正訓((株)タムラ製作所)	
	『大気圧プラズマプロセス研究の最前線 -異材接合から医療応用まで-』 (40 分)	○内田儀一郎、竹中 弘祐、節原 裕一(大阪大学)
	『材料物性の実測とシミュレーションを活用した信頼性予測技術』 (40分)	○古山 昌治、長岡 秀明、赤星 知幸、水谷 大輔、作山 誠樹((株)富士通研究所)

()内時間は、質疑応答時間を含む

※ プログラムは、都合により若干変更になることがありますので、予めご了承下さい。